

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：桂嫚婷

電話：03-5918009

E-mail：manting@itri.org.tw



1120006583007

110202 台北市信義路五段 5 號 3 樓 3E41 室

受文者：台灣電子設備協會

發文日期：中華民國 112 年 04 月 11 日

發文字號：工研轉字第 1120006583 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：本院擬舉辦「112 年度工研院技術移轉與法律中心平面顯示構裝與可撓式電子構裝技術等相關研發成果非專屬授權案」公開說明會，敬請轉知貴會會員等相關廠商把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

- 一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦 112 年度工研院技術移轉與法律中心平面顯示構裝與可撓式電子構裝技術等相關研發成果非專屬授權案之公開說明會。
- 二、「授權標的」包含專利 33 案 84 件，詳如附件。
- 三、有關本活動詳細資訊，請參考工研院研發成果公告網站：
(https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372&MGID=1216471233400146401)
- 四、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。
- 五、公開說明會：
(一) 舉辦時間：民國（下同）112 年 4 月 25 日下午 2

時至 3 時。

(二) 舉辦地點：以線上會議方式舉辦。

(三) 報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 112 年 4 月 24 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「112 年度工研院技術移轉與法律中心平面顯示構裝與可撓式電子構裝技術等相關研發成果非專屬授權案：公開說明會報名」，並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 112 年 4 月 24 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

六、聯絡人：工研院技術移轉與法律中心 桂小姐

電話：+886-3-591-8009

傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：ManTing@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣電子設備協會

院長



依權責劃分規定授權業務主管決行



112 年度工研院技術移轉與法律中心

平面顯示構裝與可撓式電子構裝技術等相關研發成果非專屬授權案

- 一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）。
- 二、非專屬授權標的：本案授權標的包含研發成果專利 33 案 84 件，詳如附件。
- 三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。
- 四、公開說明會：
 - （一）舉辦時間：民國（下同）112 年 4 月 25 日下午 2 時至 3 時。
 - （二）舉辦地點：以線上會議方式舉辦。
 - （三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 112 年 4 月 24 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「112 年度工研院技術移轉與法律中心平面顯示構裝與可撓式電子構裝技術等相關研發成果非專屬授權案：公開說明會報名」，並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 112 年 4 月 24 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
- 五、聯絡人：工研院技術移轉與法律中心 桂小姐
電話：+886-3-591-8009
傳真：+886-3-582-0466
電子信箱：ManTing@itri.org.tw
地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室



附件：

研發成果專利授權標的 (33 案 84 件)

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位
1	1	P51000167CN	面光源以及可撓性面光源	中國大陸	獲證	201210282372.9	CN103133918	20151111	20320808	經濟部技術處
	2	P51000167TW	面光源以及可撓性面光源	中華民國	獲證	101113996	TWI497016	20150821	20320418	經濟部技術處
	3	P51000167US	面光源以及可撓性面光源	美國	獲證	13/590,202	US8915634	20141223	20320824	經濟部技術處
2	4	P51070089CN	加熱器封裝體	中國大陸	獲證	201911117598.1	CN111200879	20220201	20391114	經濟部技術處
	5	P51070089TW	加熱器封裝體	中華民國	獲證	108136359	TWI717051	20210121	20391007	經濟部技術處
	6	P51070089US	加熱器封裝體	美國	審查中	16/684,597	-	-	-	經濟部技術處
3	7	P51080027CN	封裝結構	中國大陸	審查中	202010142099.4	-	-	-	經濟部技術處
	8	P51080027TW	封裝結構	中華民國	獲證	108148330	TWI739259	20210911	20391229	經濟部技術處
	9	P51080027US	封裝結構	美國	審查中	15/931,525	-	-	-	經濟部技術處
4	10	P51080078CN	半導體封裝結構	中國大陸	審查中	202010704682.X	-	-	-	經濟部技術處
	11	P51080078TW	半導體封裝結構	中華民國	獲證	109122597	TWI734545	20210721	20400702	經濟部技術處
	12	P51080078US	半導體封裝結構	美國	審查中	17/216,686	-	-	-	經濟部技術處
5	13	P51080079TW	封裝結構	中華民國	獲證	109122598	TWI751600	20220101	20400702	經濟部技術處
6	14	P51090016CN	重布線結構及其形成方法	中國大陸	審查中	202110016793.6	-	-	-	經濟部技術處
	15	P51090016TW	重布線結構及其形成方法	中華民國	獲證	109137313	TWI746231	20211111	20401026	經濟部技術處
	16	P51090016US	重布線結構及其形成方法	美國	審查中	17/159,012	-	-	-	經濟部技術處
7	17	P51090030CN	電子裝置	中國大陸	審查中	202111033662.5	-	-	-	經濟部技術處
	18	P51090030TW	電子裝置	中華民國	審查中	110132805	-	-	-	經濟部技術處
	19	P51090030US	電子裝置	美國	獲證	17/466,872	US11551829	20230110	20410902	經濟部技術處
8	20	P51090033CN	軟性電子封裝裝置的製造方法	中國大陸	審查中	202011592546.2	-	-	-	經濟部技術處
	21	P51090033TW	軟性電子封裝裝置的製造方法	中華民國	獲證	109144857	TWI789660	20230111	20401217	經濟部技術處
	22	P51090033US	軟性電子封裝裝置的製造方法	美國	獲證	17/126,033	US11363724	20220614	20401217	經濟部技術處



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位
9	23	P51090034CN	可拉伸電路和可拉伸電路布局方法	中國大陸	審查中	202011548171.X	-	-	-	經濟部技術處
	24	P51090034TW	可拉伸電路和可拉伸電路佈局方法	中華民國	獲證	109143427	TWI788740	20230101	20401208	經濟部技術處
	25	P51090034US	可拉伸電路和可拉伸電路佈局方法	美國	審查中	17/221,717	-	-	-	經濟部技術處
10	26	P51090044CN	天線模塊	中國大陸	審查中	202111091308.8	-	-	-	經濟部技術處
	27	P51090044TW	天線模組	中華民國	審查中	110121082	-	-	-	經濟部技術處
	28	P51090044US	天線模組	美國	審查中	17/498,606	-	-	-	經濟部技術處
11	29	P51100027CN	線路板與使用此線路板的電子構裝	中國大陸	審查中	202111572985.1	-	-	-	工研院
	30	P51100027TW	線路板與使用此線路板的電子構裝	中華民國	審查中	110146168	-	-	-	工研院
	31	P51100027US	線路板與使用此線路板的電子構裝	美國	審查中	17/564,225	-	-	-	工研院
12	32	P51100042CN	封裝結構、天線模塊以及探針卡	中國大陸	審查中	202210224578.X	-	-	-	經濟部技術處
	33	P51100042TW	封裝結構、天線模組以及探針卡	中華民國	審查中	111106297	-	-	-	經濟部技術處
	34	P51100042US	封裝結構、天線模組以及探針卡	美國	審查中	17/707,964	-	-	-	經濟部技術處
13	35	P51960021TW	可撓式熱電元件及其製造方法	中華民國	獲證	96125383	TWI338390	20110301	20270711	經濟部技術處
	36	P51960021US	可撓式熱電元件及其製造方法	美國	獲證	11/964,712	US7999172	20110816	20281023	經濟部技術處
14	37	P51960104US	發光模組	美國	獲證	12/046,419	US8777437	20140715	20311025	經濟部技術處
15	38	P51960112TW	線路結構及其製作方法	中華民國	獲證	97100866	TWI370714	20120811	20280108	經濟部技術處
	39	P51960112US	線路結構及其製作方法	美國	獲證	12/189,206	US8269112	20120918	20300915	經濟部技術處
16	40	P61060021CN	光電元件封裝體	中國大陸	獲證	201711445211.6	CN109004036	20200814	20371226	經濟部技術處
	41	P61060021TW	光電元件封裝體	中華民國	獲證	106145934	TWI665768	20190711	20371226	經濟部技術處
	42	P61060021US	光電元件封裝體	美國	獲證	15/951,195	US10276761	20190430	20380411	經濟部技術處
17	43	P61060026TW	封裝結構及其形成方法	中華民國	獲證	106145704	TWI660473	20190521	20371225	經濟部技術處
18	44	P61060036CN	透明顯示裝置	中國大陸	獲證	201810035746.4	CN109410758	20210309	20380114	經濟部技術處
	45	P61060036TW	透明顯示裝置	中華民國	獲證	106139692	TWI634468	20180901	20371115	經濟部技術處
	46	P61060036US	透明顯示裝置	美國	獲證	15/937,883	US10468469	20191105	20380327	經濟部技術處



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位
19	47	P51040003TW	半導體發光元件及其製作方法	中華民國	獲證	104120507	TWI572025	20170221	20350624	經濟部技術處
	48	P51040003US	半導體發光元件及其製作方法	美國	獲證	14/949,893	US9721931	20170801	20351123	經濟部技術處
	49	P51040003USD1	半導體發光元件及其製作方法	美國	獲證	15/632,392	US10037980	20180731	20351123	經濟部技術處
20	50	P51070003CN	系統封裝結構及其靜電放電防護結構	中國大陸	獲證	201811208060.7	CN110504252	20230203	20381016	經濟部技術處
	51	P51070003TWC1	系統封裝結構及其靜電放電防護結構	中華民國	獲證	107136443	TWI680560	20191221	20381016	經濟部技術處
	52	P51070003US	系統封裝結構及其靜電放電防護結構	美國	獲證	16/183,735	US11387230	20220712	20381107	經濟部技術處
21	53	P51070004CN	芯片封裝結構及其製造方法	中國大陸	審查中	201810908711.7	-	-	-	經濟部技術處
	54	P51070004TW	晶片封裝結構及其製造方法	中華民國	獲證	107115470	TWI672791	20190921	20380506	經濟部技術處
	55	P51070004US	晶片封裝結構及其製造方法	美國	獲證	16/027,374	US10950588	20210316	20380916	經濟部技術處
22	56	P51070010CN	透明顯示系統及其操作方法	中國大陸	審查中	201811104604.5	-	-	-	經濟部技術處
	57	P51070010TW	透明顯示系統及其操作方法	中華民國	獲證	107125360	TWI690748	20200411	20380722	經濟部技術處
	58	P51070010US	透明顯示系統及其操作方法	美國	獲證	16/205,241	US10891917	20210112	20381227	經濟部技術處
23	59	P51070048CN	靜電放電防護裝置與具有電容的整合被動組件	中國大陸	獲證	201910159382.5	CN111370400	20230110	20390303	經濟部技術處
	60	P51070048TW	靜電放電防護裝置與具有電容的整合被動元件	中華民國	獲證	107147215	TWI694581	20200521	20381225	經濟部技術處
	61	P51070048US	靜電放電防護裝置與具有電容的整合被動元件	美國	獲證	16/406,032	US11088135	20210810	20391118	經濟部技術處
24	62	P51070050CN	待電鍍的面板、使用其的電鍍製作工藝及以其製造的晶片	中國大陸	獲證	201910184315.9	CN110846698	20210824	20390311	經濟部技術處
	63	P51070050TW	待電鍍的面板、使用其之電鍍製程、及以其製造之晶片	中華民國	獲證	107146846	TWI700401	20200801	20381223	經濟部技術處
	64	P51070050US	待電鍍的面板、使用其之電鍍製程、及以其製造之晶片	美國	獲證	16/447,358	US10941498	20210309	20390620	經濟部技術處
25	65	P51070054TW	電子元件封裝結構及其製造方法	中華民國	獲證	107147352	TWI686920	20200301	20381226	經濟部技術處
26	66	P51080049CN	芯片封裝結構	中國大陸	審查中	201911374394.6	-	-	-	經濟部技術處
	67	P51080049TW	晶片封裝結構	中華民國	獲證	108146251	TWI717155	20210121	20391216	經濟部技術處
	68	P51080049US	晶片封裝結構	美國	獲證	16/792,905	US11362045	20220614	20400609	經濟部技術處



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位
27	69	P51090011CN	重布線結構及其形成方法	中國大陸	審查中	202010986266.3	-	-	-	經濟部技術處
	70	P51090011TW	重布線結構及其形成方法	中華民國	獲證	109132250	TWI755861	20220221	20400917	經濟部技術處
	71	P51090011US	重布線結構及其形成方法	美國	獲證	17/144,144	US11251115	20220215	20410107	經濟部技術處
28	72	P51090028CN	電容器以及包含所述電容器的濾波器與再分配層結構	中國大陸	審查中	202110022061.8	-	-	-	經濟部技術處
	73	P51090028TW	電容器以及包含所述電容器的濾波器與重佈線層結構	中華民國	獲證	109141910	TWI776290	20220901	20401126	經濟部技術處
	74	P51090028US	電容器以及包含所述電容器的濾波器與重佈線層結構	美國	審查中	17/158,014	-	-	-	經濟部技術處
29	75	P61050025TW	封裝結構及其製作方法	中華民國	獲證	106114549	TWI648830	20190121	20370501	經濟部技術處
	76	P61050025US	封裝結構及其製作方法	美國	獲證	15/673,422	US10573587	20200225	20370809	經濟部技術處
30	77	P61050033TW	封裝結構及其製作方法	中華民國	獲證	106105304	TWI637471	20181001	20370216	經濟部技術處
	78	P61050033US	封裝結構及其製作方法	美國	獲證	15/597,124	US10522438	20191231	20380123	經濟部技術處
31	79	P61060009TW	晶片封裝結構及其製造方法	中華民國	獲證	106140493	TWI636530	20180921	20371121	經濟部技術處
32	80	P61060024TW	晶片接合裝置、晶片接合的方法以及晶片封裝結構	中華民國	獲證	106137307	TWI667728	20190801	20371029	經濟部技術處
	81	P61060024US	晶片接合裝置、晶片接合的方法以及晶片封裝結構	美國	獲證	15/856,065	US10366965	20190730	20371227	經濟部技術處
33	82	P61060029CN	影像辨識系統及其信息顯示方法	中國大陸	獲證	201810159567.1	CN109408008	20211026	20380225	經濟部技術處
	83	P61060029TW	影像辨識系統及其資訊顯示方法	中華民國	獲證	106144574	TWI629675	20180711	20371218	經濟部技術處
	84	P61060029US	影像辨識系統及其資訊顯示方法	美國	獲證	16/104,096	US10817723	20201027	20381218	經濟部技術處

【備註】：本標案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。

